



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24322000000176066094

开票日期: 2024年05月27日

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司				销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W			
项目名称		规格型号		单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	250000	0.0575221238938	14380.53	13%	1869.47
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	20000	0.0575221238938	1150.44	13%	149.56
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	250000	0.0575221238938	14380.53	13%	1869.47
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	250000	0.0575221238938	14380.53	13%	1869.47
*集成电路*封装芯片		HS26P10 SOP14		只	4795	0.0530973451327	254.60	13%	33.10
*集成电路*封装芯片		HS8000P SOP16		只	4797	0.0575230462992	275.94	13%	35.87
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	133044	0.0575221238938	7652.97	13%	994.89
*集成电路*封装芯片		HS26P10 SOP16		只	4797	0.0575230462992	275.94	13%	35.87
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14		只	50000	0.0530973451327	2654.87	13%	345.13
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14		只	100000	0.0530973451327	5309.73	13%	690.27
*集成电路*封装芯片		HS0860 SOP16		只	4797	0.0575212014884	275.93	13%	35.87
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14		只	450000	0.0530973451327	23893.81	13%	3106.19
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14		只	113514	0.0530973451327	6027.29	13%	783.55
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16		只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31
合 计							¥100205.15		¥13026.67
价税合计（大写）		⊗ 壹拾壹万叁仟贰佰叁拾壹圆捌角贰分				(小写) ¥113231.82			
备注	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号: 10400101040258099;								

开票人: 周曰莲